

低融点金属型導電性接着剤

—低温接合／高温再溶融レス導電性ペースト—

1. 低温接合

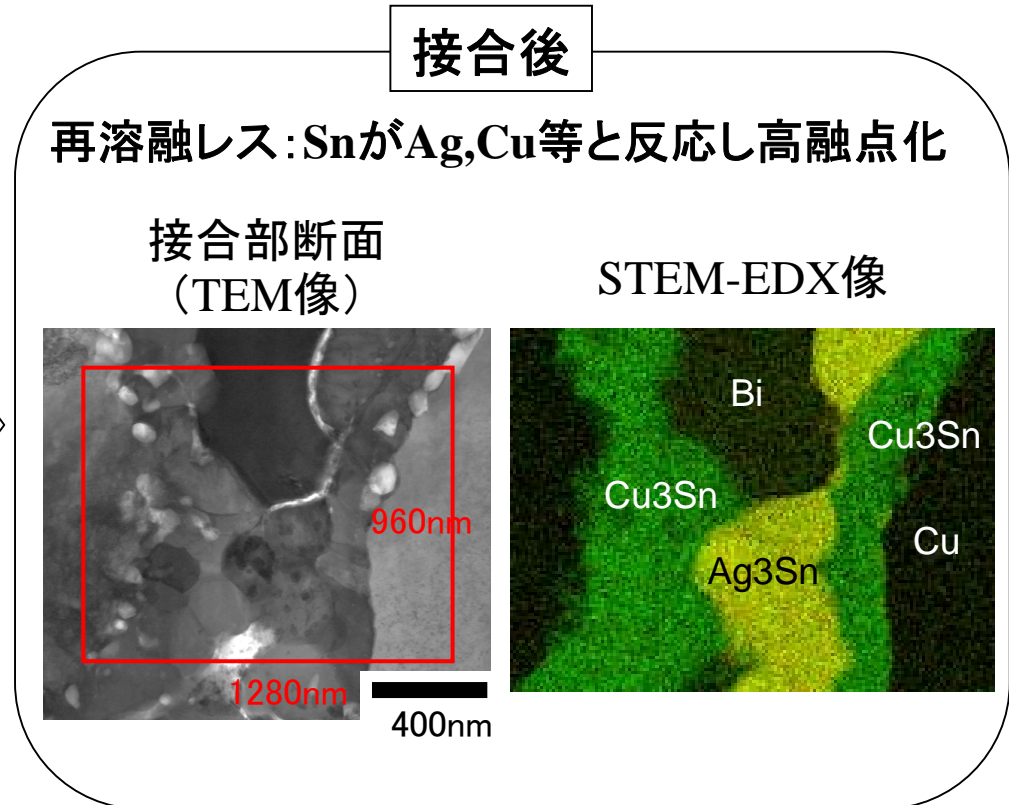
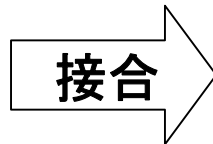
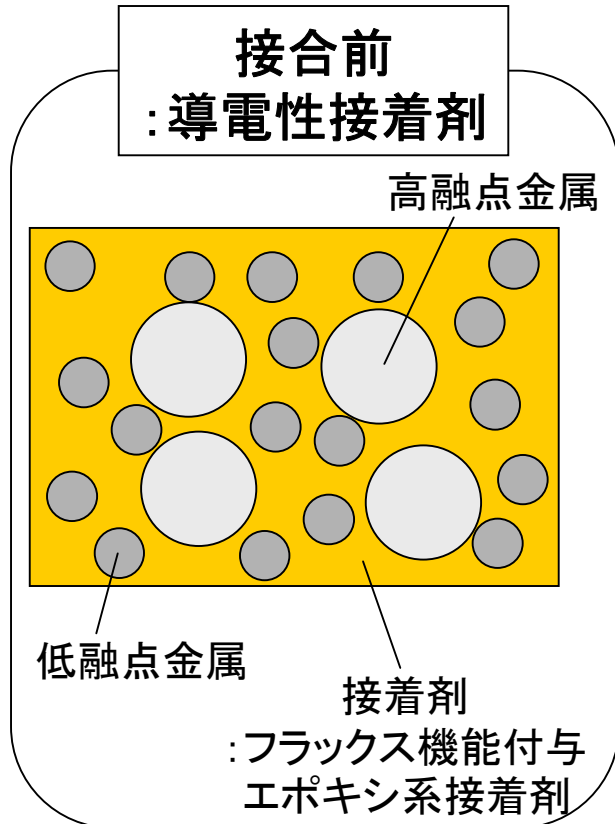
- ・低融点: 150°C以下
- ・接着剤の低温硬化

2. 再溶融レス

- ・250°C以下での材料全体の再溶融なし

3. 洗浄レス

- ・接着剤にフラックス機能付与



基板接合材料として技術確立